

● DFN3625-11Aパッケージ許容損失(JESD51-7)

DFN3625-11Aパッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1.測定条件(参考データ)

測定条件: 基板実装状態

雰囲気: 自然対流

実装: Pbフリーはんだ

実装基板: 銅箔4層基板76.2mm × 114.3mm (片面約8700 mm²) に対して銅箔面積

1層目: 銅箔無し

2層目: 70mm × 70mm_放熱板と接続有

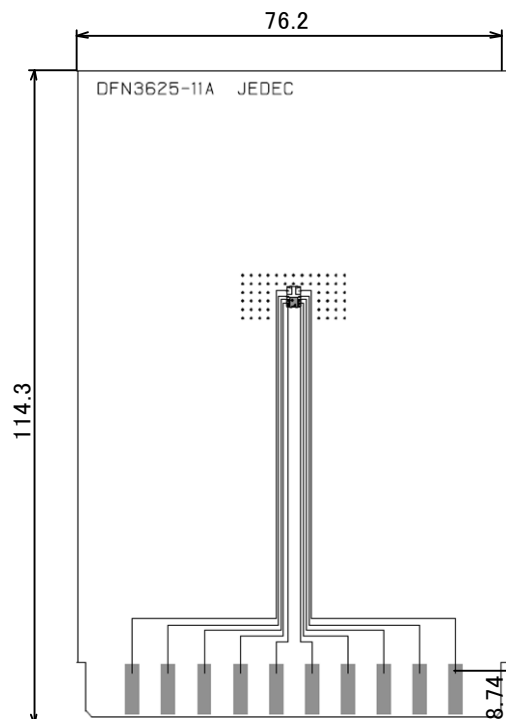
3層目: 70mm × 70mm_放熱板と接続有

4層目: 銅箔無し

基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)

板厚: 1.6mm

スルーホール: φ0.2mm 60個



評価基板レイアウト(単位: mm)

2.許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax} = 125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)	θ_{ja} (°C/W)
25	2100	47.62
105	420	

